

California Micro Devices présente une communication sur l'encapsulation sur tranches et accueille une réunion d'experts de l'IMAPS à Scottsdale

SCOTTSDALE, Arizona, 18 mars/PRNewswire/ --

- La communication de CMD sur la nouvelle technologie de repassivation sera présentée comme partie du suivi du programme du Forum WLCSP

California Micro Devices a annoncé la présentation d'une communication spécialisée sur une technologie de repassivation, compatible avec les boîtiers-puces, conçue pour minimiser les éléments parasitaires des produits ASIP(TM) (Application Specific Integrated Passive(TM)), lors de la 4ème conférence et exposition internationale annuelle sur le conditionnement des dispositifs de l'IMAPS. Cette dernière aura lieu du 17 mars au 20 mars 2008, au Radisson Fort McDowell Resort et au Casino de Scottsdale, Arizona. La présentation fera partie de la gamme de communications techniques sponsorisées par le Forum WLCSP (Wafer Level Chip Scale) sur la fiabilité de l'encapsulation sur tranches de la plaquette.

La nouvelle technologie de fabrication des boîtiers-puces améliore le rendement et la fiabilité des produits ASIP

La communication intitulée « A Novel Re-Passivation/RDL CSP Technology for Minimizing Parasitic Elements in ASIP Products », traite des aspects liés à la capacité parasitaire des technologies d'encapsulation sur tranches et elle présente un procédé de repassivation optimisée et une technologie à couche de redistribution pour boîtier-puce sur tranches pouvant entraîner une amélioration des performances électriques des produits - ayant une protection ESD (décharge électrostatique) et des filtres EMI (interférence électromagnétique) - montés sur un boîtier-puce et une amélioration de la fiabilité thermomécanique. La communication sera présentée par le Dr Umesh Sharma, directeur des opérations et de l'ingénierie de fonderie de California Micro Devices. Elle pourra être téléchargée sur le site de l'entreprise après la conférence, en consultant les pages <http://www.cmd.com/applications/papers.php>, ou le site Web du Forum Wafer Level Chipscale au <http://www.wlcspforum.org>.

Table ronde sur la fiabilité de l'encapsulation sur tranches

Durant la conférence de l'IMAPS sur le conditionnement des dispositifs, le Forum WLCSP accueillera deux débats d'experts sur la fiabilité de l'encapsulation sur tranches de la plaquette. La première séance, ayant lieu le 18 mars, comprendra une présentation de la technologie à couche de redistribution pour boîtier-puce sur tranches et la nouvelle repassivation de California Micro Devices et quatre autres communications spécialisées écrites et présentées par les membres du Forum WLCSP. La réunion des experts sera organisée par Kyle Baker, vice-président du marketing de California Micro Devices et président du Forum WLCSP.

À propos de California Micro Devices Corporation

California Micro Devices Corporation est l'un des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs analogiques et mixtes à application spécifique destinés aux combinés mobiles, d'ordinateurs personnels et d'électronique numérique grand public. Parmi ses produits clés on compte des dispositifs de protection pour les combinés mobiles, les produits électroniques numériques grand public tels que la télévision numérique, les ordinateurs personnels ainsi que les circuits intégrés à signal analogique et mixte pour les écrans des combinés mobiles.

Pour en savoir plus sur la société et ses produits, veuillez consulter le <http://www.cmd.com>.

ASIP et Application Specific Integrated Passive sont des marques de California Micro Devices Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Site Web : <http://www.cmd.com>

Source : California Micro Devices

Richard Haas de California Micro Devices, +1-408-934-3108,
richardh@cmd.com